

## 信頼性試験結果

製品名 : S-8425AxxPA-Tx-G

搭載パッケージ : 8-Pin SON(B)

No.	試験名	試験条件	時間	r/n	故障判定基準
1	高温動作	Ta=125 °C V <sub>IN</sub> = Vopr max.	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
2	高温バイアス	Ta=125 °C V <sub>IN</sub> = Vabs max.×0.9	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
3	#1 高温高湿バイアス	Ta=85 °C RH=85 % V <sub>IN</sub> = Vabs max.×0.9	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
4	#1 プレッシュャ クッカ・バイアス	Ta=125 °C RH=85 % P=2×10 <sup>5</sup> Pa V <sub>IN</sub> = Vabs max.×0.9	100 h	0/22	製品規格を満足すること
5	高温保存	Tstg max.=150 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
6	低温保存	Tstg min.=-65 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
7	#1 温度サイクル (気相)	Tstg max.=150 °C , Tstg min.=-65 °C 各 30 分	200 cycles	0/22	製品規格を満足すること
8	#1 熱衝撃 (液相)	Tstg max.=150 °C , Tstg min.=-65 °C 各 5 分	100 cycles	0/22	製品規格を満足すること
9	はんだ耐熱性 1 (リフロー)	T=260 °C 10s	3 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
10	はんだ耐熱性 2 (はんだゴテ)	T=380 °C 5s (はんだコテ先温度)	2 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
11	#2 はんだ付け性	T=230 °C はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	3 s	0/11	ゼロクロスタイムが 3 秒以内 であること 半田浸漬部分の 95%以上が 新しい半田で覆われること
12	ウイスカ 1 (室温放置)	Ta=25±3°C RH=40~70%	3 ヶ月	0/10	ウイスカサイズが 50 μm 以下 であること
13	ウイスカ 2 (温度サイクル)	Tstg max.=85 °C , Tstg min.=-40 °C 各 30 分	1000 cycles	0/10	ウイスカサイズが 50 μm 以下 であること
14	ウイスカ 3 (高温高湿放置)	Ta=60 °C RH=93 %	2000h	0/10	ウイスカサイズが 50 μm 以下 であること
15	はんだ接合強度 (せん断強度)	Tstg max.=125 °C , Tstg min.=-40 °C 各 30 分 はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	2000 cycles	0/5	初期強度値の 50%以上の 強度を維持すること
16	静電耐圧 1	V=±2000 V C=100 pF R=1.5 kΩ V <sub>IN</sub> 基準 V <sub>SS</sub> 基準 ±印加 各 5 個	5 回	0/5 合計 20 個	製品規格を満足すること
17	静電耐圧 2	V=±200 V C=200 pF R=0Ω V <sub>IN</sub> 基準 V <sub>SS</sub> 基準 ±印加 各 5 個	3 回	0/5 合計 20 個	製品規格を満足すること

18	ラッチアップ強度	±100 mA (クランプ電圧 $V_{opr\ max.}$ ) 10 msパルス $V_{IN} = V_{opr\ max.}$	1回	0/5	ラッチアップしないこと
----	----------	--	----	-----	-------------

注)  $V_{abs\ max.}$  = 絶対最大定格  $V_{opr\ max.}$  = 最大動作電圧

#1、2 : 前処理を実施後、シリーズに試験を実施する。

前 処 理 (#1)		
高温放置	吸湿処理	熱 処 理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=85 °C RH=85 % t=168 h	赤外線リフロー3回 T=260 °C t=10 s

前 処 理 (#2)		
高温放置	吸湿処理	熱処理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=105 °C RH=100% t=8 h	—